Дубл.																						
Замісп																						
Підпис																		<u> </u>				
								_														
Α	Цех	Діл	PM	1 ОПЕР. Код.назва операції														Позначення документу				
Б	Код.назва обладнання							CM	Γ	Іроф	Р	УT	KP	KO	ВД	OH	ОП	к шт	Т ПЗ	т шт		
K-M	Назва деталі.скл одиниці або матеріалу							Позначення код								СПП	OB	OH	KB	H Bump		
01	1	Мікр	ocxei	ма поз 4 (DD1) встановити на плату згідно рис.9 КЕ																		
02	2	Рел	поз	. 5 (K1) 6	встановит	и на пл	ату згід															
03	3	Діод	u nos	. 11 (VD1	1 <mark>-</mark> VD3) Bcn	пановит	и на пла	my szi	Эно рис.2 KE													
04	4	Резі	стор	л поз.6	(R1) встан	овити н	іа плату	згідно	puc.1 KE													
05	5	Резі	стор	лоз.7 ((R2) Bcma+	ювити н	на плату	згідно	puc.1 KE													
06	6	Резі	стор	8.коп ц	(R3) Bcmai																	
07	7	Резі	стор	лоз.9 (
08	8	Резі	стор	лоз.10																		
09	9	Кон	енса	nopu nos	3.2 (C1) Bc																	
10	10	Кон	енса	nopu nos																		
11	11	Тра	нзисш	ор поз.12																		
T 12		Кус	чки I	T789 98																		
K 13	2	Коні	енса	mop K10-	- 7A-H50-										796	100	100					
14	3	Коні	енса	mop K50	-29-M20-1	Омкф+-										796	100	100				
15	4	Мікр	осхен	a K56/15	J5 БК0.348										796	100	100					
16	5	Рел	R2M	-5A/250	DB-5мB/5E	3-2C-0 (1um)										796	100	100			
17	6	Резі	стор	C2-23-0	0.25-1M0 _M	ОЖО.46	7.180TY	(1wm)											796	100	100	
18	7	Резі	стор	C2-23-0	0.25-10k0m	1 +-5%	ОЖО.467	'.180TY	(1wm)										796	100	100	